

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

江苏联瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、国泰君安、诺安基金、财通基金、兴全基金等共33家机构47人次，具体名单详见附件。	
时间	2024年4月10日	
地点	连云港市花果山酒店	
上市公司接待人员姓名	董事长：李晓冬 董事会秘书：柏林 财务部长：范莉 证券事务代表：李欣安	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分 公司基本情况介绍</p> <p>公司40年始终致力于无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售，是国内行业龙头企业，拥有在功能性陶瓷粉体材料领域独立自主的系统化知识产权。公司是国家高新技术企业、国家首批专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家知识产权优势企业。</p> <p>公司主要产品有利用先进研磨技术加工的微米级、亚微米级角形粉体；火焰熔融法加工的微米级球形无机粉体；高温氧化法和液相法制备的亚微米级球形粒子；经过表面处理的各种超微粒子、多种方法制造的功能性颗粒以及为解决粒子分散开发的浆料产品。报告期内，公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、HBM等）、</p>	

新一代高频高速覆铜板（M7、M8 等）、新能源汽车用高导热热界面材料、先进毫米波雷达和光伏电池胶黏剂等下游应用领域的先进技术，持续推出多种规格低 CUT 点 Low α 微米/亚微米球形硅微粉，低 CUT 点 Low α 微米/亚微米球形氧化铝粉，高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗球形硅微粉，新能源汽车用高导热微米/亚微米球形氧化铝粉。

2023 年度，公司实现营业收入 7.12 亿元，同比增长 7.51%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.74 亿元，同比下降 7.57%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1.50 亿元，同比增长 0.21%；实现基本每股收益 0.94 元，同比下降 6.93%。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司通过整体规划布局和全体员工的共同努力，持续推动客户加快新品验证，获增更多海外市场客户认证，高端产品份额持续提升，并大力拓展导热材料等应用领域市场，推动公司业绩稳步增长。

第二部分 提问回答

问题 1：HBM 所用球铝、球硅是多少微米级的。

答：HBM 是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来堆叠层数提升、散热要求高的技术难题；同时对封装材料要求越来越高，对粉体颗粒及性能要求也越来越高。对添加的超细粉体材料，需要用到 Low α 球硅和 Low α 球铝，并且伴随着 HBM 的技术迭代升级，对于填料的需求正不断向着更低 CUT 点推进。

问题 2：一季度订单趋势如何。

答：伴随下游市场景气度的向好恢复，公司一季度订单情况良好。

问题 3: 2023 年公司面对复杂的市场环境全年营业收入保持了增长, 但净利润未同步增长, 主要是什么原因。

答: 主要系公司研发投入增加、汇兑收益减少、折旧有所增加等因素导致。

问题 4: 公司角硅、球硅的价格趋势。

答: 基于与客户之间长期信赖的合作伙伴关系, 公司产品售价相对平稳。

问题 5: 公司的 low α 相关产品是否已形成销售。

答: 公司具备从原料到成品的全套无污染生产线, 从客户端反馈来看, 仅有我司和少数日本同行在供应相关产品, 公司 Low α 球硅已经在相关客户稳定供应数年并获得客户认可, Low α 球铝目前也已实现小批量销售。

问题 6: low α 球铝产品价格相较于普通球铝是不是价格更贵。

答: 由于 low α 球铝技术、认证门槛高, 生产过程复杂、管控精准度要求高、成本相对较高, 因此相较于常规产品价格相对较高。

问题 7: 公司应用于下游高频高速覆铜板市场需求如何。

答: 相较于普通 CCL, 高频高速 CCL 具有明显的低信号损失等特点, 因此对基材介电性能、热膨胀性能、导热性能以及稳定性能提出了更高要求。近年来, 以 HPC、AI 和 5G 通信等为代表的的需求牵引, 正推动高频高速覆铜板领域的发展, 尤其是高速覆铜板领域, M6 以上的高速覆铜板市场需求正在加快, 公司产品能够精准满足新一代高频高速基板低传输损耗、低传输延时、高耐热、高可靠性等要求, 并看好未来市场发展。

	<p>第三部分 总结</p> <p>公司始终专注于工业用粉体材料领域，致力于成为客户始终信赖的合作伙伴，面向全球客户提供有竞争力的产品和解决方案。</p> <p>通过会议问答及现场调研的方式，公司解答了调研机构人员心中的问题以及调研人员对公司感兴趣的问题，调研机构人员对公司有了更多的了解和认识，对公司的产品表示认可，对公司未来的发展表示乐观，公司受到了调研机构人员的一致好评。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求调研机构签署承诺书。</p>
附件清单(如有)	详见附件

附件

参会机构及人员名单

序号	单位名称
1	淳厚基金管理有限公司
2	国泰君安股份有限公司
3	东方证券股份有限公司
4	中信建投证券股份有限公司
5	恒越基金管理有限公司
6	国联证券股份有限公司
7	平安证券股份有限公司
8	海南神采私募基金管理有限公司
9	德邦证券股份有限公司
10	财通证券资产管理有限公司
11	中银证券股份有限公司
12	野村投资管理（上海）有限公司
13	国联安基金管理有限公司
14	申万菱信基金管理有限公司
15	长江证券股份有限公司
16	中泰证券股份有限公司
17	兴全基金管理有限公司
18	国金证券股份有限公司
19	鹏扬基金管理有限公司
20	上海道翼投资管理有限公司

附件

参会机构及人员名单

序号	单位名称
21	西部证券股份有限公司
22	山西证券股份有限公司
23	北京泓澄投资管理有限公司
24	拾贝投资管理有限公司
25	华能贵诚信托有限公司
26	中信证券股份有限公司
27	中信保诚基金管理有限公司
28	诺安基金管理有限公司
29	财通基金管理有限公司
30	浙商证券股份有限公司
31	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
32	上海理成资产管理有限公司
33	北京鸿道投资管理有限公司